

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

## 灿芯半导体（上海）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>投资者关系<br/>活动类别</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者交流）  |
| <b>参与单位名称</b>         | Brilliance Asset Mngement Limited、Neo-Criterion 开域资本、Oasis Management Hong Kong、Pleiad Investment Advisors Limited、北京颐和久富投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通证券、大家资产管理有限责任公司、淡水泉、东吴基金管理有限公司、丰琰投资管理（上海）有限公司、复星保德信人寿保险有限公司、富国基金管理有限公司、光大证券、广东正圆私募基金管理有限公司、广发基金、广发证券、国金证券、国泰君安、国投瑞银基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、海通国际、海通权益投资部、海通研究所、海通证券、瀚川投资管理（珠海）有限公司、弘毅远方基金、红杉中国、湖南源乘投资管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、华安基金、华安证券、华宝基金、华泰柏瑞基金、华泰保兴、华泰证券、汇丰晋信、汇丰晋信基金管理有限公司、汇丰前海证券、惠升基金、嘉实基金管理有限公司、景顺长城、九泰基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、民生银行理财子公司、民生证券、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、南方基金、农银汇理基金管理有限公司、鹏华基金、平安资管、浦银安盛基金、筌笠资产、融通基金管理有限公司、瑞达基金、润晖投资管理香港有限公司、山西证券、上海博笃投资管理有限公司、上海峰岚资产管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、太平基金、泰康资产管理有限责任公司、万家基金管理有限公司、湘禾投资、新华资产、鑫元基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、循远资产管理（上海）有限公司、易方达基金管理有限公司、银华基金、永赢基金、圆信永丰基金管理有限公司、长城财富资产管理股份有限公司、长盛基金管理有限公司、浙商证券、中金电子、中金公司、中泰证券、中银国际、中银证券、中银基金 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 时间                    | 2024年5月22日-2024年5月23日   |
| 地点                    | 公司会议室、电话会议  |
| 上市公司<br>接待人员姓名        | 庄志青先生 董事长兼总经理<br>沈文萍女士 董事会秘书<br>彭薇女士 财务总监   |
| 投资者关系<br>活动主要内容<br>介绍 | <p>公司董事长兼总经理庄志青先生对公司 2023 年经营情况、2024 年一季度经营情况进行了简要介绍：</p> <p>2023 年，公司全年营业收入合计 134,149.26 万元，同比增长 2.99%；利润总额 18,268.20 万元，同比增长 80.15%；净利润 17,047.15 万元，同比增长 79.70%。</p> <p>2024 年一季度，公司实现营业收入 34,052.40 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,569.38 万元；研发投入合计 3,042.38 万元，同比增长 47.23%。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、请问公司的 IP 业务布局和竞争优势是什么？</p> <p>答：公司在为不同领域客户进行芯片定制设计时，不断捕捉并分析不同领域客户的共性需求，并针对泛用性较高、客户定制化需求较多且对特定应用场景具有关键作用的高性能 IP 进行研发，形成了包含高速接口 IP 与高性能模拟 IP 两大类超过 200 个半导体 IP。</p> <p>公司半导体 IP 技术支撑了公司自研 IP 平台的扩展迭代并使得公司能够在芯片定制项目中快速满足客户 IP 定制需求，提升了公司一站式芯片定制服务的综合竞争力。</p> <p>2、公司的市场竞争地位如何？</p> <p>答：公司具备较强的市场竞争力。基于全面的技术服务体系与成熟的系统级芯片设计平台，公司得以不断吸引面向不同场景的众多芯片设计公司、系统厂商等客户。同时，公司依托自身 IP 及 SoC 定制开发能力形成了可复用性高、具备应用领域扩展性的技术平台，通过持续输出技术能力帮助客户高效完成芯片定制开发及量产，使得自身竞争优势不断加强。</p> <p>3、全定制服务和工程定制毛利率有差异，商业模式上有什么差异？</p> |

答：在芯片全定制服务中，公司需要从系统层面进行整体架构设计并综合应用大规模 SoC 快速设计及验证技术、大规模芯片快速物理设计技术、系统性能评估及优化技术与工程服务技术。

在芯片工程定制服务中，公司主要应用工程服务技术与系统性能评估及优化技术帮助客户降低设计风险并保障芯片产品功能可靠实现。

4、客户类型有哪些？各类客户的持续性如何？

答：公司客户类型有系统厂商、芯片设计公司。

系统厂商聚焦软硬件系统的设计、制造与销售，面对功能多样化挑战及成本压力，为满足自身芯片定制需求，该类客户往往通过自建芯片设计团队或采购一站式芯片定制服务的方式以实现差异化竞争。但往往不会自建芯片设计团队，而是通过采购一站式芯片定制服务以满足自身发展需求。所以该类客户相对稳定。

新兴的芯片设计公司规模相对较小，创业成本较高，在创业初期往往不具备完整设计团队，但其对于下游需求及核心算法具有竞争优势。在这一发展阶段，新兴芯片设计公司往往通过采购芯片全定制服务。随着经营规模不断扩大、技术能力不断提高，其可逐渐形成全面的芯片设计能力，并成长为成熟芯片设计公司。上述情况下，该类企业亦会存在芯片定制需求。

5、公司在卫星通信领域的布局如何？

答：公司布局商用卫星通信及导航领域，为商用卫星通信及导航领域的系统厂商提供技术和服

6、项目从设计到量产的周期一般需要多久？公司如何报价？

答：

公司一般采用成本加成法进行报价，当然也考虑市场竞争情况、客户

| 公司类型     | 芯片设计周期      | 芯片量产周期    |
|----------|-------------|-----------|
| 系统厂商     | 通常在 12 个月以上 | 通常在 5 年以上 |
| 成熟芯片设计公司 | 通常在 12 个月以上 | 通常在 5 年以上 |
| 新兴芯片设计公司 | 通常在 9 个月以上  | 通常在 2 年以上 |

需求规模、客户行业地位等因素。设计业务和量产业务分别报价，各自履

约。

7、公司对未来研发团队的建设是如何规划的？

答：公司重视人才的纵向技术能力培养和横向协作能力培养，将通过建立健全科技人才培养机制，通过内部培养和外部招聘不断壮大研发团队，以提高研发团队的整体研发能力。

8、全定制和工程定制下 NRE 和量产的毛利率有什么区别？

答：对于芯片设计业务，公司全定制服务毛利率高于工程定制服务，主要系客户技术禀赋不同以及公司介入环节不同导致的工作量和承担的风险不同；对于芯片量产业务，公司全定制服务毛利率高于工程定制服务，系设计阶段工作内容差异带来的议价能力不同所致。

9、公司系统厂商客户占比如何？

答：2023 年 1 至 6 月，公司来源于系统厂商的芯片设计业务收入为 3,069.33 万元，收入占比为 11.51%；2023 年 1 至 6 月，公司来源于系统厂商的芯片量产业务收入为 19,759.37 万元，收入占比为 49.36%。

10、公司的 IP 研发方向和同行业其他公司有什么区别？公司是否销售 IP？

答：公司 IP 研发领域与创意电子等同行业公司不存在显著差异，与芯原股份在 IP 研发方面存在一定的差异。

公司主要聚焦于一站式芯片定制服务，公司 IP 研发目标是满足 SoC 定制过程中对部分关键 IP 的需求。公司有着明确的半导体 IP 研发规划及发展策略，选择针对高速接口 IP 与高性能模拟 IP 中泛用性较高、定制化需求较多且对芯片性能影响较大或尚未国产化的部分 IP 进行自主研发，形成了一系列 IP 储备并应用于主营业务中。IP 授权业务并非独立开展的业务。

|      |   |
|------|---|
|      | <p>11、如何理解公司与中芯国际的关系？</p> <p>答：（1）中芯国际曾于 2010 年 11 月通过投资开曼灿芯间接持有公司的股权。</p> <p>（2）中芯国际与公司属于产业链上下游关系，中芯国际系为芯片设计公司提供晶圆代工服务的供应商，而公司系芯片设计服务公司，为客户提供定制芯片设计服务，双方业务模式及服务内容存在显著差异。</p> <p>（3）公司与中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业中芯国际建立战略合作伙伴关系，帮助客户利用“自主、可控”供应链打造高性能定制芯片。</p> <p>（4）公司核心技术及业务开展不存在依赖晶圆代工厂的情形，公司具备基于不同晶圆代工厂工艺平台开展业务的能力。</p> <p>12、公司的一站式芯片定制业务主要涉及哪些市场领域？</p> <p>答：公司定制芯片包括系统主控芯片、光通信芯片、5G 基带芯片、卫星通信芯片、网络交换机芯片、FPGA 芯片、无线射频芯片等关键芯片，上述产品被广泛应用于物联网、工业控制、网络通信、高性能计算等众多等高新技术产业领域中，满足了不同场景差异化、个性化需求，建立了较强的竞争壁垒。公司定制芯片被应用于各色各样终端产品中，覆盖了交通出行、公共安全、大数据计算等众多场景中。</p> <p>13、未来三至五年，公司将会打造成什么样子？对公司有什么展望？</p> <p>答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。</p> <p>未来，公司将继续坚持技术创新进步，加强对新技术的研发，不断深耕对不同工艺制程的研究，助力半导体产业的蓬勃发展。</p> |
| 附件清单 | 无   |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 日期                    | 2024年5月22日、2024年5月23日 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 无                     |